

業界再編の衝撃と将来展望

「NEC エレクトロニクス」と「ルネサステクノロジ」

統合は成功するか？

| | |
|----------------------------------|----|
| 日本の半導体産業 「業界再編の衝撃と将来展望」 | 1 |
| 史上最悪を記録した 08 年度 | 1 |
| 過去 3 回の落込みと半導体業界再編 | 1 |
| がけっぷちに立つ日本の半導体産業 | 2 |
| 技術よりも経営戦略 | 3 |
| 横並び競争 | 3 |
| 引きを取らぬ技術力 | 3 |
| NEC の半導体事業改革 | 5 |
| 三大事業が相互補完でなく合併症に | 5 |
| NEC の歴代社長人事 | 6 |
| 西垣改革 DRAM 分離と、過去の不良資産の清算 | 6 |
| 第二弾 半導体事業の分離 | 6 |
| 西垣氏の社長退任と新体制 | 7 |
| 戸坂体制での新戦略と限界(02 年 4 月—05 年 10 月) | 7 |
| 大成功的 NEC エレの上場 | 7 |
| システム LSI の本格強化 | 9 |
| 混乱した NEC エレ | 9 |
| 投資削減の問題 | 9 |
| 生産能力に限界 | 10 |
| 売上が横ばい、利益急減 | 11 |
| NEC エレクトロニクスの歴代社長人事 | 11 |
| 中島体制下での路線修復(05 年 11 月—09 年 5 月) | 11 |
| 東芝との統合案 | 11 |
| ONE-NEC で再建急いだ矢野、中島体制 | 11 |
| ブームに備えて大型投資 | 12 |
| 再建 | 12 |
| NEC エレの統括 | 13 |
| NEC の半導体事業の推移 | 14 |
| NEC エレの主要製品と対象市場 | 17 |
| 主要製品 | 17 |
| 「MCU」 | 17 |
| 「ASIC」 | 17 |
| 「LCD ドライバー」 | 17 |
| 「化合物半導体」 | 17 |
| 「民生機器用」 | 18 |
| 「自動車用」 | 18 |
| 「ゲーム用」 | 18 |
| NEC エレの生産拠点 | 19 |
| 生産体系のまとめ | 20 |
| NEC エレの販売体系 | 21 |
| ルネサステクノロジの発足と経緯 | 23 |
| 日立 55% 保有だが、実質互角 | 23 |
| ルネサステクノロジの歴代会長、社長人事 | 23 |
| 長澤会長時代(03 年 4 月—05 年 3 月) | 23 |

| | |
|----------------------------|----|
| 初年度、計画を大幅に上回る | 24 |
| 出だしは好調、課題は投資 | 24 |
| 投資とコスト削減 | 24 |
| フラッシュ強化と撤退 | 24 |
| 当初の 2 年、60-70 点の及第点 | 25 |
| 半導体市場全体は絶好調 | 25 |
| 伊藤体制(05 年 4 月—06 年 3 月) | 26 |
| 携帯端末チップに力 | 26 |
| ドコモが 70 億円の開発費負担 | 26 |
| FOMA 端末の主サプライヤーに | 27 |
| 開発費の増大と海外強化 | 27 |
| 生産の外部委託を増加 | 27 |
| 開発もアジアにシフト | 27 |
| 業績低迷、望みは海外 | 28 |
| 伊藤トップ体制の総括、市況に翻弄 | 28 |
| 複数トップ体制(06 年 4 月—09 年 3 月) | 28 |
| 多機能携帯チップの受注相次ぐ | 29 |
| 07 年、市況は再び二桁成長に好転 | 29 |
| 主力路線で危機感 | 29 |
| 開発志向と巨額赤字 | 29 |
| 再統合体制 | 30 |
| ルネサスの総括 | 31 |
| ルネサスの主な推移 | 31 |
| ルネサスの主要製品と対象市場 | 35 |
| 製品と市場 | 35 |
| 主要製品 | 35 |
| 「MCU」 | 35 |
| 「携帯・モバイル」 | 37 |
| 「メモリ」 | 38 |
| 「LCD ドライバー」 | 38 |
| 「パワー、アナログ、ディスクリート」 | 38 |
| 「デジタル家電」 | 39 |
| 「ユーザー」 | 39 |
| ルネサスの生産拠点 | 40 |
| 工場閉鎖、コスト削減に限界 | 41 |
| ルネサスにみる雇用、融合策 | 42 |
| ルネサスの市場開拓、販売体制 | 43 |
| NEC エレとルネサスの組合せ | 45 |
| ソニーが 2,000 億円の巨額投資 | 45 |
| 挫折した共同ファブ構想 | 45 |
| 戸坂後の再建と東芝への接近 | 46 |
| 45nm プロセスで東芝と共同開発 | 47 |
| 東芝、システム LSI を強化 | 47 |
| 再編が起動 | 47 |
| 苦境の半導体、再編始動 | 48 |

業界再編の衝撃と将来展望

「NEC エレクトロニクス」と「ルネサステクノロジ」

統合は成功するか？

| | | | |
|-------------------------|----|---------------------------------|-----|
| “日の丸マイコン”見切り発車 | 48 | 挑戦は？ | 76 |
| 日立製作所の歴代社長人事 | 48 | 時間とサイクルへの挑戦 | 76 |
| 三菱電機の歴代社長人事 | 49 | 控えめでなく挑戦も必要 | 77 |
| 4月27日、事業統合で記者会見 | 50 | 成長と収益への挑戦 | 77 |
| 難航する正式合意 | 51 | 統合会社の売上と利益 | 77 |
| 見切り発車で破談？ | 51 | 両社の主要製品、市場の概要とモデル化収益計算 | 78 |
| 統合は破談直前に | 51 | 透明度と信頼 | 79 |
| 9月に統合基本契約を締結 | 52 | 単発的でなく長期、安定取り込み | 79 |
| 財務内容を公開 | 53 | 市場開発、営業の抜本改革 | 80 |
| 統合の本当のねらいは | 54 | 市場開拓、販売戦略で収益拡大 | 81 |
| 携帯電話用チップ統合 | 54 | 統合2社の販売体系 | 81 |
| 携帯用チップ、本当の成果は？ | 55 | NECエレは特約店経由 | 81 |
| NECと日立の組み合わせ | 55 | ルネサスは直販と代理店の並列 | 82 |
| 日本連合携帯チップ会社の出現 | 55 | 販売統合と半導体商社 | 84 |
| 日本半導体の再生、再挑戦 | 56 | 統合が商社の再編を加速 | 84 |
| 半導体産業での提携、合弁、技術交流 | 56 | 傘下代理店の今後 | 86 |
| 新統合会社、課題と挑戦 | 61 | 関連した主要商社の半導体販売額 | 87 |
| 何が課題、悪しき先例 | 61 | 統合・集約化の衝撃 | 87 |
| 時間を使したルネサスの活動開始 | 61 | 販売統合で600億円以上が剥落 | 88 |
| エルピーダメモリの歴代社長人事 | 62 | 販路統合に時間 | 88 |
| 日本的な統合と限界 | 62 | 再編が連鎖 | 89 |
| これまでの再編を総括 | 62 | 玉突き現象で試練 | 89 |
| 資産の効率化—遅々とした展開 | 62 | 第三次再編下の競合他社 | 90 |
| 「工場の統合の闇門」 | 63 | 再編は続行 | 90 |
| 旧型製品で高シェア | 63 | 再編の衝撃 構造的な問題 | 90 |
| 製品の統合、廃止の制約 | 64 | 企業規模と半導体市場 | 91 |
| 償却税制の制約 | 64 | 衰退する日本の半導体産業 | 92 |
| 投資と技術 | 65 | 半導体の国内生産、過去20年で世界シェア4割近く減 | 92 |
| 「製品での融合」 | 65 | ICのシェアが大幅減 | 93 |
| MCU分野 | 65 | 全体シェアも同様に減少 | 94 |
| 高リスクだが参入不可欠のSOC市場 | 68 | 成熟分野に依存 | 95 |
| ロジック製品とSOC | 68 | パワー、オプトはシェア保持 | 96 |
| 携帯電話用SOC | 69 | シェア漸減 | 96 |
| コンピュータ用SOC | 70 | 台湾、韓国に抜かれる | 97 |
| 民生電子機器用SOC | 70 | 宝の山だったのは過去 | 99 |
| SOC、収益確保にリスク分散 | 71 | 哲学思想、統治・指導力 | 100 |
| 投資資金調達—タイミングと制約 | 71 | 思想・哲学不在 | 100 |
| 基本戦略—市場停滞とブーム | 72 | 指導力・統治不在 | 101 |
| 単独路線、合弁路線の明暗 | 74 | 今後と将来への葛藤 | 101 |
| 親子の距離 | 74 | 再編は成功するか | 102 |
| 2社合弁での課題 | 74 | 樂観的なシナリオ | 103 |
| 経済産業省の支援と限界 | 75 | 悲観的なシナリオ | 103 |
| 企業再生強化策 | 75 | | |
| 裏目に出た統合時の優遇策 | 75 | | |